

旺矽科技股份有限公司 人才培育獎助學金申請辦法

一、目的

旺矽科技股份有限公司(以下稱本公司)為培育理科、工科等相關領域優秀人才並獎勵優秀學生，特設立人才培育獎助學金申請辦法，針對碩/博士生，辦理本項獎學金。

二、獎學金分為獎助學金及到職獎金兩種，內容說明如下：

1. 獎助學金：

(1)獎助名額：每年合計共 10 名，本公司得視申請狀況增減獎助名額。

(2)獎助生名稱：通過本公司審核且持續具備本辦法鎖定獎助資格之獲獎學生(以下簡稱旺矽獎助生)

(3)獎助金金額：

身分	每期金額	最多期數	最高獎助學金
碩士生	10 萬/期	4 期	40 萬
碩士生(產業合作)	15 萬/期	4 期	60 萬
博士	25 萬/期	6 期	150 萬

(4)發放時間及給付方式：取得獎助學金資格後，次年一月底及七月底前各匯入一期獎助學金金額，至獎助生提供之個人銀行帳戶。

(5)獎助說明：採擇優錄取制，每名碩士生獎助期限最多為兩年(四學期)，每名博士生獎助期限至多為三年(六學期)。

2. 到職獎金：旺矽獎助生畢業後至本公司報到任職者，本公司加發到職獎金金額如下：

身分	每年金額	最多次數	最高到職獎金
碩士生	10 萬/年/次	2 次	20 萬
碩士生(產業合作)	15 萬/年/次	2 次	30 萬
博士生	25 萬/年/次	2 次	50 萬

到職獎金發放時間：分別於通過試用期後次月及任職年資滿一年後之次月分兩次撥付，到職獎金併入撥付當月薪資中發放。。

三、申請條件

1. 校系別：提出申請時就讀臺灣大學之理工科相關科系碩/博士班。

2. 身分別：日間部碩士班/博士班一般生(不包含任何在職形式進修者)

3. 成績：

(1)歷年學業平均成績為 80 分以上。

(2)歷年操行平均成績為 80 分以上且自入學後至申請日前均未受過處分者

四、申請期間：

1. 自公告日起至 10 月 15 日止，於申請時間內(郵戳為憑)以掛號方式連同其它備審資料郵寄至本公司人力資源部，地址：302 新竹縣竹北市中和街 155 號。(註明人才培育獎學金申請)。

2. 檢附文件：

(1) 制式申請表乙份(請浮貼 2 吋照片)。

(2) 學生證、身分證正反面影本各乙份，並浮貼於(附表一)上。

- (3) 個人資料蒐集、處理及利用同意書。
- (4) 在學成績單(碩一生提供大學歷年成績單正本、碩二生提供上一學年之成績單(需含學業成績平均分數、排名,並加蓋學校印信),博一生提供碩士歷年成績單正本,博二生同碩二生。
- (5) 碩一及博一新生必須檢附研究所錄取證明
- (6) 指導教授推薦函一份(碩一新生請檢附大學就讀校系之老師推薦函)博一新生請檢附碩士就讀校系之老師推薦函。
- (7) 自傳、研究計畫或學習生涯規劃
- (8) 專題研究、參賽獲獎紀錄證明及其他各類優秀佐證影本(個人證照、期刊論文發表..)。

五、評核標準：

本公司審核分為兩階段，由公司邀請評審委員審核決定，並保留最終決定權。

1. 第一階段：書面審查(審查結果，另行通知)

項目	細項說明	占比
研究能力	自傳、研究計畫、學習生涯規劃	30%
	專題報告、期刊論文學術研究成果	20%
	其他有利審查之資料 (期刊投稿、專題研究、證照、得獎紀錄)	20%
學業、操行成績	歷年在學成績及操性成績	30%

2. 第二階段：書面審查通過後，進行第二階段面試。

項目	細項說明	占比
表達能力	研究計畫報告、專業知識與實務經驗	50%
發展潛力	可塑性、未來貢獻度	20%
契合度	人格特質與本公司企業文化契合度	20%
其他	服裝儀容、反應、態度等	10%

六、獎助資格確認：

本公司於核定獲獎學生名單後，於當年12月15日(含)前，將個別通知獲獎學生。

七、旺矽獎助生義務：

1. 獎助期間之義務

(1)旺矽獎助生應於每學期結束時主動以email或書面繳交該學期成績單至本公司人力資源部，以便本公司評核是否延續獎助資格。獎助資格之評核，以該學期學業平均成績及操性成績均達80分以上為標準，且所有科目成績均需及格，並不可有違反校規遭記過處分之情事。如旺矽獎助生無法達此標準，應提出書面說明取得本公司同意以延續獎助資格，若未獲本公司核可，本公司將取消獎助資格。

(2)本公司將視年度需求提供寒暑假實習機會，旺矽獎助生經指導教授同意，得到本公司實習，實習期間薪資依本公司規定，但不計入工作年資，實習期間之住宿及交通之費用由旺矽獎助生自行負擔。

2. 旺矽獎助生畢業後若到本公司任職，核敘之薪資與職位依本公司規定以碩士/博士學歷核定，福利比照本公司正式員工。

3. 旺矽獎助生對於所接觸或知悉本公司或其相關企業之內部機密資訊，負有保密義務。

八、獎助學金及到職獎金追償方式：

1. 旺矽獎助生如有下列情事之一者，即喪失獎助資格，本公司得停止發給獎助學金：

- (1) 於入學當年度申請保留入學資格或未完成註冊，或中途休、退、輟學。
- (2) 獎助期間，學業成績平均未達 80 分或操性低於 80 分，且未獲本公司同意延續獎助資格。
- (3) 獎助期間內放棄接受獎助資格。
- (4) 申請轉校或轉系且申請之系所非本獎助方案所列之各相關研究所。
- (5) 受判刑宣告確定。
- (6) 有侵害他人之智慧財產權情事。
- (7) 有違反獎助學金合約情事。
- (8) 於獎助期間或至本公司服務期間有其他不當行為，經本公司審議取消獎助資格。

2. 旺矽獎助生到職後，到職獎金已領第一年則依到職後未滿 12 個月的日數比例返還，已領第二年到職金則依到職後未滿第 13 個月至第 24 個月的日數比例返還。

3. 返還方式：

- (1) 以「已受領之全部獎助學金及到職獎金(含政府規定之代扣各項規費，包含但不限於所得稅、補充保費)」相同額度之金額，無息返還本公司。
- (2) 旺矽獎助生於接獲本公司返還獎助金及到職獎金之通知後，應於 7 日內以電匯方式一次匯款至本公司指定銀行帳戶。

九、旺矽獎助生如有受領獎學金後，因意外事故或疾病因素導致喪亡或肢體、心神遭受損害，已領取之獎學金，並得於免於追償。(須提供醫生診斷證明)

旺矽科技股份有限公司
 人才培育獎助學金說明事項

項目	備註
申請期間	自公告日起至 10 月 15 日止
申請條件	1. 校系別：提出申請時就讀，臺灣大學之半導體領域相關科系 2. 身分別：日間部碩/博士班一般生(不包含任何在職形式進修者) 3. 成績： (1)歷年學業平均成績為 80 分以上。 (2)歷年操行平均成績為 80 分以上且自入學後至申請日前均未受過處分者 4. 未受領其他有約定提供服務等附隨義務之獎助學金者。
寄件方式	申請時間內(郵戳為憑)以掛號郵寄方式將應繳資料寄至「旺矽科技人力資源部」 地址：302 新竹縣竹北市中和街 155 號
申請文件	請將下列資料按順序由上而下排列整齊，並以迴紋針於左上角固定
	<input type="checkbox"/> 1. 人才培育獎助學金申請表
	<input type="checkbox"/> 2. 身分證、學生證正反面影本各乙份(浮貼於附表一上)
	<input type="checkbox"/> 3. 個人資料蒐集、處理及利用同意書
	<input type="checkbox"/> 4. 歷年在學成績單(成績上面必須由校方註明班上總人數排名) (碩一新生請提供大學成績單)(博一新生請提供碩士成績單)
	<input type="checkbox"/> 5. 碩一/博一新生必須檢附研究所錄取證明
	<input type="checkbox"/> 6. 指導教授推薦函一份(碩一新生請檢附大學就讀校系之專任老師推薦函)
	<input type="checkbox"/> 7. 自傳、研究計畫或學習生涯規劃
<input type="checkbox"/> 8. 專題研究、參賽獲獎紀錄證明及其他各類優秀佐證影本(個人證照、期刊論文發表..)	
注意事項	1. 如因申請表件不齊或資料填寫不全者，恕不受理申請。 2. 繳交之審核相關文件資料，概不退還。 3. 郵戳為憑，逾期恕不受理

旺矽科技股份有限公司

人才培育獎助學金申請表

姓名		學號		<input type="checkbox"/> 碩一 <input type="checkbox"/> 碩__ <input type="checkbox"/> 博一 <input type="checkbox"/> 博二 <input type="checkbox"/> 博__					
身分證字號		出生年月日		性別					
地址	通訊地	(請浮貼) 2吋照片							
	戶籍地 <input type="checkbox"/> 同通訊地								
聯絡電話						電話：	手機：		
Email									
目前就讀學校/系所						(附上學生證)			
指導教授									
學歷	學位	校名	科系	學制	起訖 (西元年/月~西元年/月)				
	碩士			研究所					
	大學			大學/四技/二技					
學業成績	歷年成績/排名	學業平均成績：_____；操行平均成績：_____							
英文檢定成績		測驗機構		分數	測驗時間				
家長聯絡人		姓名		關係	電話				
如有受領其他有服務義務約定之獎助學金者，不符本公司獎學金申請條件。 是否領有其他有服務義務約定之獎助學金？ <input type="checkbox"/> 是，機構_____ <input type="checkbox"/> 否									

- 茲證明以上所填寫資料均屬實。
- 本人已詳讀旺矽科技人才培育獎助學金辦法，並願意遵守相關規定。
- 本人同意本公司查核申請之任何有關資料。

申請人：_____ (簽名) _____年____月____日

-----以下由公司填寫-----

※申請條件審查結果： 通過 不通過

※審核流程

總經理	審查委員	審查成績
<input type="checkbox"/> 核准獎助學金發放 <input type="checkbox"/> 不核准獎助學金發放 簽名：		書面審查平均成績： 面試平均成績： 排名： 預計錄取單位：

附表一

身分證(正反面影本)	學生證(正反面影本)
<p>(請浮貼)</p> <p>身分證正面</p>	<p>(請浮貼)</p> <p>學生證正面</p>
<p>(請浮貼)</p> <p>身分證反面</p>	<p>(請浮貼)</p> <p>學生證反面</p>

個人資料蒐集、處理及利用告知書 暨個人意願表達書

旺矽科技股份有限公司(以下簡稱本公司)因人才招募、聘僱或任職本公司後員工管理所需，而對當事人之個人資料進行蒐集、處理、利用時，本公司依個人資料保護法第 3 條、第 8 條、第 9 條及第 19 條規定，向當事人告知相關事項如下：

一、蒐集者名稱：旺矽科技股份有限公司(包括總公司及分公司)

二、蒐集的目的：○○二人事行政管理、○三一全民健康保險、勞工保險、○三六存款與匯款、○六四保健醫療服務、○六九契約、類似契約或其他法律關係事務、○七三政府資訊公開、檔案管理及應用、○七八計畫、管制考核與其他研考管理、一〇七採購與供應管理、一〇九教育或訓練行政、一一四勞工行政、一一八智慧財產權、光碟管理及其他相關行政、一二九會計與相關服務、一三六資(通)訊與資料庫管理、一三七資通安全與管理、一四五僱用與服務管理。

三、個人資料之類別：識別類(C001 識別個人者、C002 識別財務者、C003 政府資料中之辨識者)、特徵類(C011 個人描述、C012 身體描述、C013 習慣、C014 個性)、家庭情形(C021 家庭情形、C022 婚姻之歷史、C023 家庭其他成員之細節、C024 其他社會關係)、社會情況(C039 執照或其他許可)、教育考選技術或其他專業(C051 學校記錄、C052 資格或技術、C054 職業專長、C057 學員或應考人記錄)、受僱情形(C061 現行之受僱情形、C062 僱用經過、C064 工作經驗、C065 工作差勤記錄、C066 健康與安全記錄、C068 薪資與預扣款、C070 工作管理細節、C071 工作之評估細節、C072 受訓記錄)、健康與其他(C111 健康記錄)等及其他可以直接或間接識別該個人且為本公司人事管理運作相關的資料。

您於提供家庭狀況、緊急聯絡人、緊急聯絡電話、介紹人等非由該當事人提供之個資時，請您務必確認已對該當事人告知且該當事人已同意您會將該當事人之個資提供予本公司，本公司將依法蒐集、處理、利用其個人資料。

四、個人資料利用之期間、地區、對象及方式：

- (1) 期間：若經錄取，您的個人資料將依公司員工個人資料保護方式處理；若未被錄取，您的個人資料將配合公司每年度統一銷毀文件作業時間點一併銷毀。
- (2) 地區：本公司及分公司營運地區。
- (3) 對象：本公司及分公司內部相關人員使用，以利資料處理、分析。
- (4) 方式：作為蒐集之特定目的範圍內使用。

(背面尚有資料)

五、當事人依據個資法第 3 條規定得行使之權利及方式：

當事人得以書面方式向本公司提出請求，就其蒐集之個資，答覆查詢、提供閱覽或製給複製本(得依法酌收必要成本費用)、補充或更正個人資料，及要求對其個資停止蒐集、處理或利用，或刪除其個人資料。

六、當事人得自由選擇是否提供個人資料，不提供將對其權益之影響：

當事人倘不願意提供個人資料或不同意本公司蒐集、處理或利用其個人資料者，本公司將無法判斷您的個人資料之正確性及所應徵職務之適任性等，以至於影響您覓得適當的職缺。

對於上述事項，同意者，請勾選『同意』欄位並請親自簽名及填寫身份證字號，同意本公司於上述目的範圍內蒐集、處理及利用其個人資料；不同意者，請勾選『不同意』欄位並請親自簽名，聲明放棄面試權利。

~~~~~

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><input type="checkbox"/> <b>本人同意</b></p> <p>本人確實知悉以上個人資料保護告知事項內容，並同意旺矽科技於上述目的範圍內蒐集、處理及利用個人所提供之各項資料。</p> <p>姓名：</p> <p>身份證字號：</p> <p>日期：            年            月            日</p> | <p><input type="checkbox"/> <b>本人不同意</b></p> <p>本人不願意提供個人資料或不同意旺矽科技於上述目的範圍內蒐集、處理及利用個人所提供之各項資料，特此聲明放棄面試權利。</p> <p>姓名(聲明人)：</p> <p>日期：            年            月            日</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|